

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-065

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟将半导体硅片生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年，其余固定资产折旧年限保持不变。本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。

● 杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计估计变更采用未来适用法，自 2023 年 7 月 1 日起执行，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司 2022 年度及以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

● 经财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产折旧费用约 11,911.82 万元，扣除所得税和少数股东损益影响后，预计增加公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 8,797.04 万元，最终影响金额以公司正式披露的 2023 年年度审计报告为准。

一、本次会计估计变更概述

根据公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合行业标准与公司实际经营情况，公司将半导体硅片生产设备的折旧年限由10年变更为20年，包括单晶炉、切磨抛设备、外延炉、检测及清洗设备等，其余固定资产折旧年限保持不变。

公司于2023年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，基于谨慎性原则，本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计估计变更的内容和原因

1. 变更原因及内容

根据公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”以及“使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的规定。公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。

公司主营业务包含半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片三大板块，其中公司控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司及金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司为半导体硅片行业的领军企业，长期致力于半导体硅片的研发与生产。

半导体硅片行业属于资金与技术“双密集型”的行业，要形成规模化、商业化的生产，需要进行金额巨大的固定资产投资。公司半导体硅片生产设备占公司固定资产比例情况如下：

项目	净值金额或比重
拟变更折旧年限的半导体硅片生产设备金额（万元）	356,682.34
总的机器设备金额（万元）	545,069.27
拟变更折旧年限的半导体硅片生产设备占总的机器设备的比重	65.44%
总的固定资产金额（万元）	684,303.57
拟变更折旧年限的半导体硅片生产设备占总的固定资产的比重	52.12%

半导体硅片的生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，都需要大量的技术人员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于上述

的行业特点，半导体硅片的生产线从投产至达到设计产能，通常需要经历一个相对较长的产能爬坡期。

半导体生产设备主要由机械零部件构成，零部件得到正常更新维护的情况下，半导体硅片生产设备可使用相当长的时间，一般可以达到20年以上。浙江金瑞泓科技股份有限公司自2001年起陆续完成硅片生产设备的安装调试并转为固定资产，开始批量生产并销售，截至2023年6月30日，公司半导体硅片生产设备使用期限已超过15年的机器设备原值金额为25,541.55万元，占公司全部半导体硅片生产设备的比重为4.29%，其中使用期间超过20年的机器设备原值金额为8,663.59万元，占公司全部半导体硅片生产设备的比重为1.45%，使用期限超过15-20年的机器设备与本次拟变更折旧年限的半导体硅片生产设备基本一致。上述使用期限超过15-20年的机器设备目前仍在继续使用，其产出效率及产品合格率与新设备没有差别。根据公司相关设备实际运行情况判断，上述设备在未来一段时间内仍可以保持稳定运行、实现稳定产出。

同时根据2022年度同行业可比上市公司定期报告，公司进行相应折旧年限变更后，与同行业上市公司的同类资产折旧不存在重大差异。半导体硅片行业上市公司机器设备折旧年限情况如下：

证券简称	证券代码	类别	折旧年限（年）
沪硅产业	688126	机器设备	3-15
中晶科技	003026	机器设备	5-15
有研硅	688432	机器设备	5-25

公司变更前后固定资产折旧对比如下表：

固定资产类别	变更前		变更后	
	折旧年限（年）	残值率	折旧年限（年）	残值率
房屋及建筑物	10-40	5%	10-40	5%
机器设备	5-10	5%	5-20	5%
运输工具	5-8	5%	5-8	5%
电子设备及其他	3-5	5%	3-5	5%

综上所述，半导体硅片生产设备折旧年限按照10年计提已与公司设备实际情况不相符合。公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定及固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，也使公司会计估计更加符合相关设备的实际使用情况，同时折旧年限变更后与同行业上市公司同类资产折旧方法不存在重大差异，因此公司认为本次会计估计变更的原因是充分且合理的。

2. 本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自2023年7月1日开始执行。

（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司2023年度的财务报表将产生影响。

根据公司2023年6月末固定资产存量情况，经财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少公司2023年度固定资产折旧费用约11,911.82万元，扣除所得税和少数股东损益影响后，预计增加公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约8,797.04万元，最终影响金额以公司正式披露的2023年年度审计报告为准。

（三）过去三年实施本次会计估计变更的模拟影响

假定此项会计估计变更于2020年1月1日起实施，根据变更后的机器设备折旧年限，对公司利润总额、净资产或总资产的影响如下：

年度	利润总额影响金额（万元）	总资产影响金额（万元）	净资产影响金额（万元）
2020年	6,624.94	6,624.94	5,085.39
2021年	9,269.92	15,894.86	6,961.25

2022年	15,574.58	31,469.45	11,604.73
-------	-----------	-----------	-----------

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1. 独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计估计变更程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的要求，变更后的会计估计符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，能够真实、客观的反映公司财务情况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2. 监事会意见

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。监事会同意本次会计估计变更。

3. 会计师事务所意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司会计估计变更的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9374号），认为：“立昂微公司管理层编制的会计估计变更的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年8月修订）》及其他相关规定的要求，如实反映了立昂微公司会计估计变更情况。”

四、审计委员会审议情况

2023年9月21日，公司审计委员会成员在2023年审计委员会第六次会议通讯表决一致同意本次公司会计估计变更事项。

审计委员会认为：针对公司的实际经营情况，按照《企业会计准则第4号——固定资产》

第十九条的规定，调整固定资产使用寿命能够更加客观、真实地反映公司的实际经营情况和资产状况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意此次会计估计变更。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年9月29日